

## 半導体製造装置部品(静電チャック)の新製造棟が竣工 ～生産能力約2倍、半導体需要増に対応～

住友大阪セメント株式会社(社長:諸橋央典、本社:東京都港区)は、市川事業所(千葉県市川市)において半導体製造装置の主要部品である静電チャックの新製造棟を建設し、2026年7月9日に竣工式を執り行いましたのでお知らせいたします。

本製造棟は、DXや生成AIなどの普及に伴うデータ取扱量の飛躍的な増大を背景に、拡大する半導体需要に対応するための生産能力増強投資の一環として、静電チャックの生産能力を従来比約2倍に増強することを目的として建設いたしました。

### 1. 静電チャックについて

静電チャック(ESC、Electrostatic Chuck)は、半導体製造の真空プロセスにおいて静電気力を用いてシリコンウェハを固定する、半導体製造装置の主要部品です。

当社の静電チャックは、セメント事業で培った無機材料技術の知見を応用して自社開発したSiC(炭化ケイ素)ナノ粒子を用いており、吸着力と耐電圧に優れたナノ複合化セラミックスを特長とし、最先端半導体で求められるシリコンウェハのエッチング性能向上に貢献してきました。

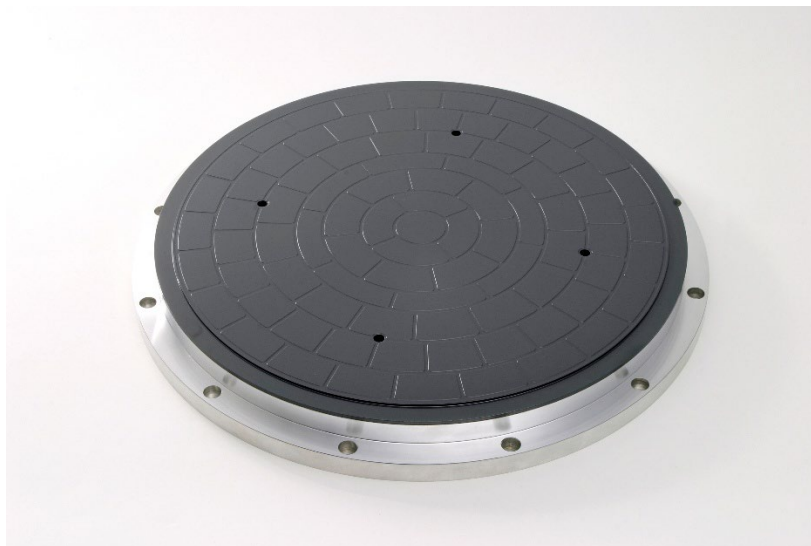


写真1. 静電チャック

## 2. 新製造棟について

本製造棟は、静電チャックの安定供給体制の構築を目的として、2023年7月より建設を進めてきました。

設備の増強に加え、自動化設備や、生産管理システムなど最新鋭の技術を導入することで、生産性の向上と更なる高品質要求に対応可能な体制を構築しています。

竣工 : 2026年7月9日

所在地 : 市川事業所（千葉県市川市二俣新町）

延床面積 : 約 10,000m<sup>2</sup>



写真2. 新製造棟外観

当社は、中長期ビジョン「SOC Vision2035」のもと、事業ポートフォリオ変革として、高機能品事業の更なる拡大を掲げております。2026年4月1日からは新たに高機能品事業本部を立ち上げ、組織体制を強化しました。今回の新製造棟建設による静電チャックの生産能力拡大はその基盤となるものであり、まずは足元の市場成長に伴い増加する顧客需要を確実に取り込むとともに、半導体製造装置向け製品分野において、新製品も含めた更なる成長の実現を目指してまいります。

### 【本件に関する問い合わせ先】

住友大阪セメント株式会社 企画部 TEL 03-6370-2725